

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】令和7年2月26日(2025.2.26)

【国際公開番号】WO2023/243619
【出願番号】特願2024-528866(P2024-528866)
【国際特許分類】
H05K 3/38(2006.01)
【FI】
H05K 3/38 A

10

【手続補正書】
【提出日】令和6年11月19日(2024.11.19)
【手続補正1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項1】

20

主面を有するベースフィルムと、
前記主面上に配置されている導電層とを備え、
前記ベースフィルムは、フッ素樹脂により形成されており、
前記導電層は、互いに結合されている複数の導電粒子を含む層であり、
前記主面における窒素の存在量は、0.2原子パーセント以上である、プリント配線板用基板。

【請求項2】

前記導電粒子は、主成分を銅又は銀とする粒子である、請求項1に記載のプリント配線板用基板。

【請求項3】

30

前記導電層の厚さは、0.05 μ m以上2.0 μ m以下である、請求項1に記載のプリント配線板用基板。

【請求項4】

前記導電粒子の平均粒径は、1nm以上500nm以下である、請求項1に記載のプリント配線板用基板。

【請求項5】

前記導電層上に配置されている銅めっき層をさらに備える、請求項1に記載のプリント配線板用基板。

【請求項6】

前記銅めっき層は、無電解銅めっき層又は電解銅めっき層である、請求項5に記載のプリント配線板用基板。

40

【請求項7】

前記ベースフィルムは、フィラーを含有しているフッ素樹脂により形成されている、請求項1に記載のプリント配線板用基板。

【請求項8】

前記フィラーは、シリカにより形成されている、請求項7に記載のプリント配線板用基板。

【請求項9】

前記フッ素樹脂がポリテトラフルオロエチレンである、請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のプリント配線板用基板。

50

【請求項 10】

主面を有するベースフィルムと、
前記主面上に配置されている配線とを備え、
前記ベースフィルムは、フッ素樹脂により形成されており、
前記配線は、前記主面上に配置されている導電層を有し、
前記導電層は、互いに結合されている複数の導電粒子を含む層であり、
前記主面における窒素の存在量は0.2原子パーセント以上である、プリント配線板。

10

20

30

40

50